

No. : 8/IMDIA/XII/09

Hal : Pelaksanaan Seminar IMDIA bulan Januari

Kepada Yth.

Seluruh anggota IMDIA

Dengan hormat,

Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan kepada IMDIA.

Seminar pada bulan ini merupakan seri ke 4 dari serangkaian seminar mold/die series kesesuaian (matching) antara mold/die material dan machining tool. Dengan bantuan dari HITACHI Group dan dukungan dari Komite Teknologi IMDIA, akan dilaksanakan seminar teknologi, dengan detail sebagai berikut ini:

1. Tujuan : Dengan teknologi machining terbaru kesesuaian antara mold/die (casting) material dan tools yang digunakan dalam proses pembuatan mold/die, proses machining bisa dilaksanakan dengan presisi sekaligus bisa memperpendek waktu prosesnya. Dengan memahami hal tsb melalui seminar ini, merupakan kesempatan bagi peserta untuk mereview metode proses machining selama ini.
2. Target peserta : Designer, procurement, penanggung jawab mold/die
3. Waktu : **Kamis, 28 Januari 2010 pukul 14:00 - 16:00**
4. Tempat : **YPMG Auditorium**
Graha Manajemen YPMG, Kompleks PT. Panasonic Manufacturing Indonesia
Jl. Raya Bogor Km. 29 Jakarta Timur 13710
5. Tema : **Seminar Teknologi Machining Terbaru dengan mold/die material dan cutting tools yang sesuai (matching)**
6. Pembicara : **Mr. Takeshi Imayoshi (HITACHI Tools International Business Dept.)**
Mr. Taichi Yano (HITACHI Metal Singapore)
7. Biaya : **Gratis (Non member Rp 50,000)**

Untuk itu kami sangat mengharapkan partisipasi seluruh anggota IMDIA.

Dikarenakan keterbatasan tempat, maka tiap corporate member diperkenankan mengirimkan maksimal 3 partisipan saja. Dalam seminar disiapkan interpreter yang akan menterjemahkan dari bahasa Jepang kedalam bahasa Indonesia.

Terima kasih.

Jakarta, 5 Januari 2010

Ketua Indonesia Mold & Dies Industry Association

Makoto Takahashi

Ikut Seminar Tidak ikut seminar

Balasan:

Re-Fax No. 021-871-7864

Re-email Ms. Novianti (novianti@imdia.or.id)

(Apabila ikut berpartisipasi silahkan isi formulir dibawah)

Nama Perusahaan :
(Nama Anggota) (Untuk individual member tidak dapat diwakilkan)

Nama peserta :

:

:

Kami mengharapkan balasan melalui e-mail maupun fax selambat-lambatnya hari Jumat, 22 Januari 2010, pukul 12:00 WIB